

# 上海硅产业集团股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

股票名称：沪硅产业

股票代码：688126

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位/个人	中金、国信、广发、海通、麦格里、长江、中泰等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。
时间	2024年8月31日
地点	线上交流
公司接待人员	邱慈云、李炜、黄燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、半导体行业和沪硅产业经营情况介绍</p> <p>随着人工智能、云计算、物联网、新能源汽车等新兴技术得到更广泛的应用，持续推动产业升级和经济转型，半导体行业在经历产业周期的调整后，开始逐步复苏，且长期发展前景依然向好。</p> <p>细分到半导体硅片，在经历了2023年的市场大幅下调后，我们预计将在2024年触底，但目前尚未出现明显增长趋势，这主要是因为，作为产业链的上游环节，行业复苏传导到硅片端都还需要一定的时间，硅片市场的复苏将会滞后于终端市场、芯片制造等产业链的下游环节。数据上来看，2024年上半年，全球半导体硅片整体出货量仍然呈现同比下降态势，相较于2023年上半年下滑约11%，其中，300mm硅片出货量自第二季度起开始出现回升，但200mm及以下尺寸的</p>

产品需求仍然低迷。

在此大背景下，公司 2024 年上半年硅片产品的出货趋势也基本与全球市场走势保持一致。上海新昇的 300mm 硅片随市场出现复苏迹象及公司产能的持续提升，出货量同比有所增加，但新傲和 Okmetic 的 200mm 及以下尺寸硅片及受托加工服务的销量仍较为疲软，出货量有所下降。今年上半年，公司收入总计 15.69 亿元，与去年上半年基本持平。但是由于价格方面受到的巨大压力，叠加持续扩产带来的折旧摊销费用、持续较高水平的研发投入及其他固定成本增加的影响，公司上半年的利润相关指标有所下滑。

但是随着下游客户明显的去库存预期以及半导体市场的持续回暖，我们相信半导体硅片出货量及价格的回暖也值得期待。

300mm 硅片方面。经过持续建设，到今年上半年总产能已达到 50 万片/月，预计到年底将完成 60 万片/月的生产能力建设目标。得益于二季度起 300mm 硅片市场开始回升，300mm 硅片的出货量较去年同期有较大增长，但由于价格的压力，导致收入增长比例小于销量增长比例。但是我们预期随着客户库存水平的进一步下降，价格压力有望得到缓解。此外，在现有上海产能布局的基础上，我们还启动了新一轮的产能建设，将在现有基础上再新增 60 万片/月，最终达到 120 万片/月。目前，我们在太原的建设已经全面启动，预计年内可实现中试线 5 万片/月的产能。

200mm 硅片方面。受 200mm 市场持续低迷、价量齐跌的影响，公司该业务板块受到的影响较大，新傲科技和 Okmetic 在收入上均有超过 25% 以上的跌幅，从而也影响到了公司整体的业绩表现。预计后续

随着市场的回暖，两家子公司的业务都会有一定的回升。在此期间，我们也将不断为后续迎接市场回暖做好准备，新傲科技将持续积极开拓 IGBT/FRD 产品应用市场，Okmetic 也持续在先进传感器、功率器件、射频滤波器及集成无源器件等高端细分领域巩固市场地位。

此外，在 SOI 材料方面，除了在 200mm 业务持续开展的同时，我们还在继续推进 300mm SOI 产品的开发，现已完成了中试线的建设，并在积极的推动产品的开发与验证工作，以期更好地满足射频等应用领域市场和客户需求。

总体来说，虽然由于半导体产业处于周期性调整的大环境，公司上半年业绩受到了影响，但是从长期来看，行业整体发展还是积极向好的，我们也希望半导体硅片能够加快恢复的节奏，步入快速上升通道。

## 2、投资者交流

问：公司上半年的毛利率出现下降的原因。

答：上半年毛利率下滑主要还是因为 ASP 下降，后续随着下游客户明显的去库存预期以及半导体市场的持续回暖，价格应该也会逐步回暖。

问：未来三年的产业布局。

答：未来三年会更为完整，除了已有的存储和逻辑以外，还会在新能源和汽车行业布局，特别是在重掺和功率器件方面进行加强，目前这些应用在国内也有比较快速的成长，总体来说，我们对未来的竞争格局还是比较有信心的。

问：在建工程转固的政策以及太原的折旧政策。

答：公司在建工程转固是按照达到预定可使用状态就去转固的会计政策。太原到今年年底计划要有 5 万片的产能，达到预定可使用状态时也会进行转固，后续产能也是同样的会计政策。

问：太原产能偏重的领域以及后续的拉设备节奏。

答：太原的产能整体布局还是以轻掺为主，满足存储和逻辑应用的需求。但是，公司在重掺及新能源应用方面的产能布局将主要在太原开展。太原的整体产能节奏我们一直在持续安排中，将综合建设进度及市场需求综合考虑。

问：新项目选址太原的考虑及国产化设备的使用情况。

答：主要还是考虑山西丰富的电力资源，且也与国家的产业政策相符合。太原产线会进一步加大国产装备和国产材料的使用比例。

问：芬兰的的扩产节奏及后续市场需求。

答：目前还是按计划建设进度稳步推进中。在新产能开出后，行业应该已经进入回稳上升期，万一回暖速度不如预期，我们也会及时调整投资节奏。

问：12 寸 SOI 的产能规划。

答：目前已建成产能约 6 万片/年的中试线，后续将按计划建设 40 万片/年的产能。

问：目前公司的高附加值产品种类。

答：高附加值产品除了 SOI 外，还有一些比较特殊应

	<p>用的产品，8寸和12寸的都有。公司会持续寻求一个更合理更好的产品结构以帮助提高整体毛利水平。</p> <p>问：目前公司的产能利用率及出货情况。</p> <p>答：公司的整体情况与全球趋势整体一致，12寸随市场出现复苏迹象及公司产能的持续提升，产能利用率也比较高，出货量同比也有所增加，但中小尺寸产品还未完全复苏，产能利用率和出货量都有下降。</p> <p>问：IGBT应用方面的进展。</p> <p>答：目前已进入小批量阶段，后面也会将一些产品生产转移到太原，我们也会与客户一同推进新产能的验证，争取尽快在那边批量生产并向客户提供服务。此外，我们目前也在向国外客户提供IGBT样品。</p> <p>问：公司提高毛利率水平的策略。</p> <p>答：最重要的还是要持续提高ASP，相信后续随着整个业界景气度的恢复，价格也会得到调整。同时我们也会继续加大研发力度，推出一些高附加值的新产品和特殊工艺产品。此外，公司在生产制造端也在持续不断的做很多控制成本的动作。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年8月31日